

SIEMENS
Ingenuity for life

エレクトロニクス・イノベーション・フォーラム 2019 「Re:think! Digital Transformation」 実例に学ぶ！イノベーションを加速するデジタル・エンタープライズ

2019/8/28 (水) 10:00 ~ 17:00
トラストシティ カンファレンス・丸の内

本セミナーでは、エレクトロニクス業界が抱える製品開発から生産までの課題において、既に成果を出されているお客様の事例やシーメンスの最新ソリューションをご紹介します。

市場への製品投入サイクルの短期化や多品種少量生産への対応など、エレクトロニクス業界の競争環境は大きく変化しており、製品の新たな設計製造環境の構築が必須といえます。

実例を交えながら、変革期のビジネスをどのように成功へ導いていけるのかについてお話しします。

主なセッション内容

【ゲスト基調講演】

「パナソニックデザインの変革」

イノベーションを加速させるパナソニックデザインのクリエイティブ環境改革
パナソニック株式会社様

「インデント製品開発への3DCAD-BOM関係構築の事例ご紹介」
3D AID様

【ユーザー事例講演】

セイコーエプソン株式会社様、株式会社デンソー様、パナソニック株式会社様、
ローム株式会社様、Hana Microelectronics Public Co., Ltd.様

【シーメンス講演】

デジタル・ツイン、クローズド・ループ・マニファクチャリングなどをベースに最新
ソリューションをご紹介します

セミナー概要

日時:
2019年8月28日 (水)
10:00 ~ 17:00

会場:
トラストシティ カンファレンス・丸の内
JR東京駅 日本橋口より徒歩1分

主催: シーメンス株式会社
シーメンスDIソフトウェア

参加費: 無料 (事前登録制)

対象者:
エレクトロニクス業界メーカー、およびサ
プライヤー様 (製品設計、開発、製造
部門のエンジニア、企画、ITの皆様)

お問合せ:
エレクトロニクス・イノベーション・
フォーラム 2019 登録事務局
siemens-event@ext-web.net

※同業他社様の方のご参加はお断りさせて
いただく場合がございますので、予めご了承
くださいますようお願いいたします。

セミナーの詳細・お申込みはこちら



www.siemens.com/plm/jp/eif-2019

弊社の個人情報保護方針については、以下をご参照ください。
<https://www.siemens.com/jp/ja/home/general/skk-privacy-policy.html>

予定プログラム

ジェネラルセッション

10:00-10:10	ご挨拶 シーメンスDIソフトウェア エレクトロニクス&セミコンダクター営業部 部長 山岸 敏樹
10:10-10:50	【ゲスト基調講演】 「パナソニックデザインの変革」 イノベーションを加速させるパナソニックデザインのクリエイティブ環境改革 パナソニック株式会社 デザイン本部 本部長 (兼) アプライアンス社デザインセンター 所長 臼井 重雄 氏
10:50-11:30	【ゲスト基調講演】 インデント製品開発への3DCAD-BOM関係構築の事例ご紹介 3D AID 代表 伊藤 卓郎 氏
11:30-12:10	デジタル・エンタープライズ- Re:think! Digital Transformation シーメンスDIソフトウェア インダストリー営業本部 本部長 貴島 雅史

12:10-13:10

ご昼食

分科会

	Track A 先進事例	Track B 「Re:think! Digital Transformation」
13:10-13:50	【ユーザー事例講演】 FloEFDを用いた設計者CAE推進活動 セイコーエプソン株式会社 伊原 有希 氏	製品開発業務における働き方改革のヒント シーメンスの考える業務管理手法とは シーメンスDIソフトウェア 竹内 克也
13:55-14:35	【ユーザー事例講演】 NX、Xpeditionを活用したエレメカ連携の業務改善検証について パナソニック株式会社 大迫 周平 氏	Simcenterポートフォリオによる電子機器熱設計ソリューションのご紹介 シーメンスDIソフトウェア 武井 春樹
14:40-15:20	【ユーザー事例講演】 両面冷却パワーモジュールの過渡熱測定 株式会社デンソー 杉浦 和彦 氏	さらなる競争力確保へ！クローズド・ループ・マニファクチャリング推進 - 設計/製造システム (PLM) & 製造実行システム (MOM) の連携 シーメンスDIソフトウェア 野田 智孝

15:20-15:35

休憩

15:35-16:15	【ユーザー事例講演】 (逐次通訳) エレクトロニクス・マニファクチャリングにおける製造実行システム (MES) の導入 Hana Microelectronics Public Co., Ltd., イアン・タイスハースト 氏	バリューを増産せよ! - メカ・エレキ連携で絶え間なく生産性を改善 - シーメンスDIソフトウェア 藤田 茂
16:20-17:00	【ユーザー事例講演】 コンポーネントの小型化に貢献する6in1パワーモジュールの過渡熱解析 ローム株式会社 安武 一平 氏	【シーメンス事例講演】 (逐次通訳) エレクトロニクス・マニファクチャリングにおけるスマートファクトリーの本質と効果 シーメンスDIソフトウェア サギ・ルーヴェン

セッション内容

ジェネラルセッション

10:00-10:10

ご挨拶

シーメンスDIソフトウェア
エレクトロニクス&セミコンダクター営業部
部長 山岸 敏樹

10:10-10:50

【ゲスト基調講演】

「パナソニックデザインの変革」

イノベーションを加速させるパナソニックデザインのクリエイティブ環境改革

パナソニック株式会社 デザイン本部 本部長（兼）アプライアンス社デザインセンター
所長 臼井 重雄 氏

パナソニック（株）アプライアンス社デザインセンターは家電デザイン開発を通じて、憧れのくらしの実現を目指す部門です。多様化、IOTにより急変する未来のくらしを描き、プロダクトから空間、サービス・ソリューション開発を行うためデザインの役割は大きく広がっています。イノベーションを加速させ、アジャイル開発に向けたデザインプロセスの変革と、それを高いクオリティで具現化するITツールの導入と活用。クリエイティブ性の発揮と効率化を目指す、パナソニックデザインのITイノベーションの狙いと取り組みをご紹介します。

10:50-11:30

【ゲスト基調講演】

インデント製品開発への3DCAD-BOM関係構築の事例ご紹介

3D AID

代表 伊藤 卓郎 氏

中堅設計者の激減状況で一層の開発効率化が求められています。諸施策はありますがやはり3D設計の更なる深耕が肝と考えます。3DCADとBOMの密関係がその核ですが、とくにインデント製品開発においては、BOP中心で動いていてBOMが無い、あるいはBOMはあるが3DCADとの関係がないところも多いです。インデント製品開発へのBOM導入の事例を通して3DCADとBOMとの密関係の重要性を改めてご説明します。

11:30-12:10

デジタル・エンタープライズ- Re:think! Digital Transformation

シーメンスDIソフトウェア

インダストリー営業本部

本部長 貴島 雅史

競争が激化するイノベーションの時代、この時代をリードするためには高い顧客価値を創出し続ける必要があります。その為に先進的なグローバル企業はデジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組み顧客価値とバリューチェーンの革新を続けています。本セッションでは、イノベーションを加速させるために欠かせないデジタルトランスフォーメーション（DX）の中核となる製品ライフサイクル全体のデジタル・ツインとそのプラットフォームの重要性をグローバルトレンド、先進事例を交えて紹介します。

分科会セッション内容

Track

A

先進事例 (ユーザー事例講演)

13:10-13:50

FloEFDを用いた設計者CAE推進活動

セイコーエプソン株式会社
ソフトウェア技術開発部
伊原 有希 氏

電子機器（プリンター等）の高機能化・小型化に伴い、放熱設計が不可欠となり、現象を可視化し、原理を把握した理論設計が必要である。製品の品質向上及び設計効率化のために、開発・設計者自身も熱流体シミュレーションする活動を推進している。その推進活動を紹介する。

13:55-14:35

NX、Xpeditonを活用したエレメカ連携の業務改善検証について

パナソニック株式会社 アプライアンス社
スマートライフネットワーク事業部
イメージングBU 技術管理部 実装設計課
大迫 周平 氏

製品開発において、実装基板を製品に配置する際には実装部品側とメカ側とのコミュニケーションが必要となります。実装部品側とメカ側では利用するツールが違うため、スムーズにコミュニケーションを取ることが出来ないことによる課題が多くあります。本講演では、NX、Xpeditonを活用したエレメカ連携の効率化検証の効果を紹介いたします。

14:40-15:20

両面冷却パワーモジュールの過渡熱測定

株式会社デンソー
エレクトロニクス研究部
次世代パワーモジュール研究室
室長 杉浦 和彦 氏

自動車の電動化が加速しており、EVやHV向けのパワーモジュールの出力密度が増加している。パワーモジュール設計の重要なアイテムの一つに冷却性能（熱設計）がある。HVに採用されている両面冷却パワーモジュールは、放熱経路が両面にあるため放熱性の高い構造であるが、その過渡熱測定データの解析が難しい。本セッションでは実機の測定データを示して両面冷却パワーモジュールの過渡熱特性を検証する。

15:20-15:35

休憩

15:35-16:15

エレクトロニクス・マニファクチャリングにおける製造実行システム (MES) の導入 (逐次通訳)

Hana Microelectronics Public Co., Ltd.,
シニア・コーポレート MIS マネージャー
イアン・タイスハースト 氏

タイ、中国、米国、カンボジア等の複数生産拠点をベースにEMSソリューションを提供するハナ・グループ(HANA:TB)における生産ラインのマネジメント、リアルタイムな見える化とトレーサビリティを実現する為のチャレンジ、マイルストーン及び今後の展開についてご紹介いたします。

16:20-17:00

コンポーネントの小型化に貢献する6in1パワーモジュールの過渡熱解析

ローム株式会社
アプリケーションエンジニア部
グループリーダー
安武 一平 氏

パワーエレクトロニクスの世界では、パワーデバイスの大容量化と小型化により、放熱設計が不可欠となっております。本講演では、過渡熱抵抗測定と解析を活用したIGBTモジュールの熱設計事例を中心に、ロームのアナログパワー技術をご紹介します。

分科会セッション内容

Track

B

Re:think! Digital Transformation

13:10-13:50

製品開発業務における働き方改革のヒント
シーメンスの考える業務管理手法とは

シーメンスDIソフトウェア
プリセールス本部 ビジネスコンサルティング
上席コンサルタント 竹内 克也

働き方改革の実現が、全ての企業における大命題となっている一方で、製品開発業務では慢性的な対応工数不足が続いており、限られたリソースで計画とおりに業務を完遂させることが不可欠となっています。
本セッションでは、日程、作成物、人員等の業務管理手法に着目し、シーメンスの統合されたソリューション群で製品開発業務の生産効率を向上させる可能性について紹介させていただきます。

13:55-14:35

Simcenterポートフォリオによる電子機器熱設計ソリューションのご紹介

シーメンスDIソフトウェア
シミュレーション コンサルタント 武井 春樹

シーメンスのSimcenterポートフォリオでは電気、電子、半導体業界向けの様々な問題解決のためのソリューションを取り揃えております。
本講演では、熱に起因する問題を熱流体解析を中心にしながら、構造、電磁場、音響、機構、システム解析から熱測定、音響測定などのハードウェアなどの様々な物理領域をまたがるソリューションを紹介いたします。

14:40-15:20

さらなる競争力確保へ！クローズド・ループ・マニファクチャリング推進 - 設計/製造システム (PLM) & 製造実行システム (MOM) の連携

シーメンスDIソフトウェア
プリセールス本部 部長 野田 智孝

Industrie4.0時代を迎え、事業軸 (ERP) と製品軸 (PLM) の交点である製造領域のシステム整備 (MOM) が現在注目されています。シーメンスは、PLMとMOMを連携させ、さらなる効率向上と製品開発強化を図るソリューションであるクローズド・ループ・マニファクチャリング (CLM) を推奨します。CLMの肝となる情報は、PLMで作成する製造部品表管理 (MBOM) です。
このセッションでは、Teamcenter ManufacturingでのMBOMに関するCapabilityと、CLMの価値についてご提案致します。

15:20-15:35

休憩

15:35-16:15

バリューを増産せよ！
- メカ・エレキ連携で絶え間なく生産性を改善 -

シーメンスDIソフトウェア
テリトリー営業本部
ビジネス開発 技術課長 藤田 茂

高度な製品になればなるほど、メカとエレキの要素を擦り合わせて設計開発することになります。ここでメカ設計とエレキ設計の担当部門間の連携不足が主因で手戻りが起こり、想定より時間を費やしてしまうケースが多いのが課題と言えるでしょう。メカ-エレキ連携をより深く確実に実行できれば、この課題を解決でき、分野の違うお互いの担当を信頼し、信頼される業務ループを実現できます。このようにメカ設計とエレキ設計の連携管理を美し、限られた時間の中でもバリューを増産できるTeamcenterを中核としたシステムをご紹介します。

16:20-17:00

【シーメンス事例講演】
エレクトロニクス・マニファクチャリングにおけるスマートファクトリーの本質と効果 (逐次通訳)

シーメンスDIソフトウェア
製造オペレーション管理 (MOM) -
Valor担当 ビジネス開発マネージャー
サギ・ルーヴェン

本セッションでは、Industrie4.0のトレンドとエレクトロニクス・マニファクチャリングにおける効果についてご説明します。なぜ今、工場がデジタル化が重要なのか、そしてデジタル化へのROIをどう評価するのか、そして、製造の改善を図るためにスマートデータを使ってどう機械学習を使用するのか、シーメンスのFürth工場を例にとってご説明します。